

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

截至2025年12月31日止年度之年度業績

財務摘要

- 本集團截至2025年12月31日止年度的總收入為6,590.1百萬港元(2024年：4,647.9百萬港元)，較截至2024年12月31日止年度增加41.8%。
- 本集團截至2025年12月31日止年度的毛利為409.5百萬港元(2024年：311.7百萬港元)，較截至2024年12月31日止年度增加31.4%
- 截至2025年12月31日止年度，本公司擁有人應佔淨利潤為161.4百萬港元(2024年：100.3百萬港元)，較截至2024年12月31日止年度增加60.8%。
- 截至2025年12月31日止年度，本公司每股基本及攤薄盈利分別為34.85港仙(2024年：21.41港仙)及34.59港仙(2024年：21.39港仙)。
- 董事會議決建議宣派本公司截至2025年12月31日止年度的末期股息每股14港仙(2024年：每股10港仙)。

年度業績

芯智控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」或「我們」)截至2025年12月31日止財政年度(「報告期」)的經審核綜合業績連同去年之比較數字，如下：

綜合損益表

截至2025年12月31日止年度

	附註	2025年 千港元	2024年 千港元
收入	3	6,590,109	4,647,896
銷售成本		<u>(6,180,580)</u>	<u>(4,336,214)</u>
毛利		409,529	311,682
其他收入		18,970	21,276
其他收益或虧損淨額		208	2,739
貿易應收款項(減值虧損)/撥回		(2,617)	8,335
研發費用		(34,240)	(31,456)
行政費用		(66,104)	(72,990)
銷售及分銷費用		(152,888)	(105,142)
應佔聯營公司業績		38,710	7,065
財務費用		<u>(30,355)</u>	<u>(26,619)</u>
除稅前利潤		181,213	114,890
所得稅費用	5	<u>(20,085)</u>	<u>(13,837)</u>
年度利潤	6	<u>161,128</u>	<u>101,053</u>
以下人士應佔：			
本公司擁有人		161,353	100,342
非控股權益		<u>(225)</u>	<u>711</u>
		<u>161,128</u>	<u>101,053</u>
每股盈利	8	港元	港元
基本		<u>34.85仙</u>	<u>21.41仙</u>
攤薄		<u>34.59仙</u>	<u>21.39仙</u>

綜合損益及其他全面收入表
截至2025年12月31日止年度

	2025年 千港元	2024年 千港元
年度利潤	161,128	101,053
其他全面收入：		
其後可能重新分類至損益的項目：		
換算海外業務產生的匯兌差額	<u>12,278</u>	<u>(6,319)</u>
年度其他全面收入(扣除稅項)	<u>12,278</u>	<u>(6,319)</u>
年度全面收入總額	<u><u>173,406</u></u>	<u><u>94,734</u></u>
以下人士應佔：		
本公司擁有人	173,604	94,077
非控股權益	<u>(198)</u>	<u>657</u>
	<u><u>173,406</u></u>	<u><u>94,734</u></u>

綜合財務狀況表

於2025年12月31日

	附註	2025年 千港元	2024年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		4,579	6,083
使用權資產		36,051	9,368
商譽		20,159	20,159
無形資產		11,097	4,737
會所債券		5,960	5,856
透過其他全面收入按公平值列賬的 金融資產		41,786	40,085
透過損益按公平值列賬之金融資產		148,144	144,213
於聯營公司之投資		150,890	121,011
按金		4,350	2,025
遞延稅項資產		2,279	1,304
		<u>425,295</u>	<u>354,841</u>
流動資產			
存貨		292,340	190,118
貿易應收款項及應收票據	9	1,173,903	658,354
按金、預付款項及其他應收款項		35,919	58,267
已抵押銀行存款		182,684	192,881
銀行及現金結餘		153,960	239,455
		<u>1,838,806</u>	<u>1,339,075</u>
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	10	494,193	341,874
合約負債		26,829	18,627
應付一間聯營公司款項		4,920	5,265
其他應付款項及應計費用		84,730	41,768
租賃負債		10,060	6,822
銀行及其他借貸	11	529,872	303,659
即期稅項負債		22,084	10,926
		<u>1,172,688</u>	<u>728,941</u>
流動資產淨值		<u>666,118</u>	<u>610,134</u>
總資產減流動負債		<u>1,091,413</u>	<u>964,975</u>

	附註	2025年 千港元	2024年 千港元
非流動負債			
租賃負債		27,031	2,669
銀行及其他借貸	11	1,396	2,530
		<u>28,427</u>	<u>5,199</u>
資產淨值		<u>1,062,986</u>	<u>959,776</u>
資本及儲備			
股本		38	38
儲備		1,061,016	959,294
本公司擁有人應佔權益		1,061,054	959,332
非控股權益		1,932	444
權益總計		<u>1,062,986</u>	<u>959,776</u>

綜合財務報表附註

截至2025年12月31日止年度

1. 一般資料

本公司根據開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。其母公司為Smart IC Limited，為在英屬處女群島註冊成立的私營公司，其最終控股方為田衛東先生(「田先生」)。本公司註冊辦事處及主要營業地點的地址披露於年度報告公司資料一節。

本公司是一家投資控股公司。其附屬公司之主要業務為從事電子元件貿易。

本公司的功能貨幣為美元(「美元」)，而本集團綜合財務報表的呈列貨幣為港元(「港元」)。為方便使用財務報表的人士，綜合財務報表以港元呈列，原因為本公司股份於聯交所上市。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則

本集團已採納香港會計師公會頒佈及對本報告期間強制生效的所有新訂或經修訂香港財務報告準則及詮釋。採納有關準則對綜合財務報表並無重大影響。

3. 收入

(a) 來自客戶合約的收入分拆

	2025年 千港元	2024年 千港元
貨品或服務類別		
銷售電子元器件	<u>6,590,109</u>	<u>4,647,896</u>
收入確認時間		
按即時確認	<u>6,590,109</u>	<u>4,647,896</u>
銷售渠道／產品線		
授權分銷		
— 智能終端	3,849,231	3,195,328
— 存儲	1,903,240	763,428
— 算力基建	<u>737,161</u>	<u>635,792</u>
	6,489,632	4,594,548
混合分銷	<u>100,477</u>	<u>53,348</u>
	<u>6,590,109</u>	<u>4,647,896</u>

(b) 來自客戶合約的履約責任

本集團於貨品的控制權轉移，即貨品交付至銷售協議所訂明之交貨港口或客戶指定地點時確認銷售電子元器件的收入。交貨完成後，客戶承擔貨品報廢及損失的風險。

本集團可根據銷售合約條款收取預付款項。本集團收取的任何交易價格確認為合約負債，直至貨品交付予客戶為止。一般信貸期為交貨後0至120天。

於2025年及2024年12月31日，所有尚未履行的銷售合約預期將於報告期末後12個月內獲履約。

(c) 分配至來自客戶合約剩餘履約責任的交易價格

所有電子元器件銷售的期限為一年或更短。根據香港財務報告準則第15號的允許，並無披露分配至該等未履行合約的交易價格。

4. 分部資料

主要營運決策者已確定為本公司的董事。為分配資源及評估分部業績，董事審閱本集團之內部報告時集中於所交付貨品類別。本集團已識別的兩個可報告分部如下：

- (a) 授權分銷，包括集成電路（「IC」）產品分銷，該等產品於行業國際知名IC品牌列表中直接採購並授權銷售。
- (b) 混合分銷，包括獨立分銷本集團自市場其他現成可得供應商處採購的IC產品以及透過電商平台進行的其他分銷及服務。

於達致本集團的可報告分部時，概無合併計算任何經營分部。

本集團的可報告分部為提供不同產品及服務的策略業務單位。由於各業務須應用不同技術及市場推廣策略，故該等可報告分部須分開管理。

可報告分部的會計政策與本集團的會計政策相同。分部利潤指各分部賺取的利潤，而並無分配未分配費用、應佔聯營公司業績、透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值收益及終止合併一間附屬公司收益。此乃向董事呈報以分配資源及評估表現之衡量基準。

董事按各分部的經營業績作出決定。由於董事並無就分配資源及表現評估定期審閱分部資產及分部負債，故並無呈列有關資料分析。因此，僅呈列分部收益及分部業績。

可報告分部損益的資料：

	授權分銷 千港元	混合分銷 千港元	分部總計 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
截至2025年12月31日止年度					
來自外部客戶的收入	6,489,632	100,477	6,590,109	-	6,590,109
分部間銷售*	4,412	6,578	10,990	(10,990)	-
	<u>6,494,044</u>	<u>107,055</u>	<u>6,601,099</u>	<u>(10,990)</u>	<u>6,590,109</u>
分部利潤	<u>113,820</u>	<u>7,640</u>	<u>121,460</u>	<u>-</u>	<u>121,460</u>
截至2024年12月31日止年度					
來自外部客戶的收入	4,594,548	53,348	4,647,896	-	4,647,896
分部間銷售*	3,064	3,104	6,168	(6,168)	-
	<u>4,597,612</u>	<u>56,452</u>	<u>4,654,064</u>	<u>(6,168)</u>	<u>4,647,896</u>
分部利潤	<u>83,225</u>	<u>11,006</u>	<u>94,231</u>	<u>-</u>	<u>94,231</u>

* 分部間銷售按成本收取

可報告分部損益的對賬：

	2025年 千港元	2024年 千港元
損益		
可報告分部總利潤	121,460	94,231
未分配金額：		
未分配費用	(312)	(3,321)
透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值收益	4,006	3,078
應佔聯營公司業績	38,710	7,065
出售一間聯營公司部分權益之虧損	(1,315)	-
加密貨幣減值虧損	(1,421)	-
年內綜合利潤	<u>161,128</u>	<u>101,053</u>

地區資料：

本集團主要在香港、中國、新加坡及日本經營業務。

下表載列本集團按地區市場(基於相關集團實體成立所在的司法權區，亦即其於本年度的經營地點，不分貨品來源及客戶地理位置)劃分的銷售額分析。

來自外部客戶的收入(基於相關集團實體的經營地點)

	2025年 千港元	2024年 千港元
香港	3,174,355	2,564,489
中國	1,944,510	1,604,987
新加坡	1,450,546	468,903
日本	680	248
其他	20,018	9,269
綜合總計	<u>6,590,109</u>	<u>4,647,896</u>

有關主要客戶的資料：

本年度向客戶銷售貨品的收入佔本集團總收入10%以上的客戶如下：

	2025年 千港元	2024年 千港元
授權分銷分部		
客戶1	696,711	不適用
客戶2	不適用	不適用

附註：截至2024年12月31日止年度，並無個別客戶佔超過本集團總收入10%以上。

5. 所得稅費用

	2025年 千港元	2024年 千港元
即期稅項		
香港利得稅	12,604	6,968
中國企業所得稅	3,756	4,467
新加坡企業所得稅	4,196	712
其他	468	9
	<u>21,024</u>	<u>12,156</u>
遞延稅項	<u>(939)</u>	<u>1,681</u>
	<u>20,085</u>	<u>13,837</u>

6. 年度利潤

本集團年度利潤已扣除／(計入)以下各項：

	2025年 千港元	2024年 千港元
董事酬金	19,828	11,526
員工成本(不包括董事酬金)：		
薪金、工資及其他津貼	69,038	72,129
酌情花紅	26,886	23,865
退休福利計劃供款	12,663	12,357
員工成本總額	<u>128,415</u>	<u>119,877</u>
無形資產攤銷(計入銷售及分銷費用)	1,579	1,579
物業、廠房及設備折舊	2,267	2,102
使用權資產折舊	9,442	8,760
以股份為基礎付款開支	6,658	304
核數師酬金		
— 年度核數服務	1,310	1,330
— 其他核數服務	301	203
— 非核數服務	300	340
確認為費用的存貨成本(不包括存貨撥備)	6,170,308	4,349,197
存貨撥備／(撥回存貨撥備)(計入銷售成本)	<u>10,272</u>	<u>(12,983)</u>

7. 股息

	2025年 千港元	2024年 千港元
2025年中期股息每股普通股0.03港元 (2024年：2024年中期股息每股普通股0.02港元)	13,905	9,234
2024年末期股息每股普通股0.10港元 (2024年：2023年末期股息每股普通股0.05港元)	<u>46,109</u>	<u>23,469</u>
	<u>60,014</u>	<u>32,703</u>

於報告期結束後，本公司董事建議派付截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股14港仙(2024年：截至2024年12月31日止年度之末期股息每股普通股10港仙)，合共約68,415,000港元(2024年：46,109,000港元)，惟須待股東於應屆股東大會上批准。

8. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃按以下數據計算：

	2025年 千港元	2024年 千港元
盈利		
就計算每股基本及攤薄盈利而言的盈利	<u>161,353</u>	<u>100,342</u>
	2025年	2024年
股份數目		
就計算每股基本盈利而言的普通股加權平均數	462,933,479	468,664,074
受限制股份單位(「受限制股份單位」)產生的潛在攤薄普通股之影響	<u>3,490,411</u>	<u>505,464</u>
就計算每股攤薄盈利而言的普通股加權平均數	<u>466,423,890</u>	<u>469,169,538</u>

截至2025年及2024年12月31日止年度，就計算每股基本盈利而言的普通股加權平均數，已計及受託人就未歸屬獎勵股份及未授出股份而根據本公司股份獎勵計劃自市場購入的普通股(經根據本公司股份獎勵計劃歸屬的普通股調整)。

本公司擁有人應佔每股基本盈利按本公司擁有人應佔年度利潤除以年內已發行普通股的加權平均數計算。

9. 貿易應收款項及應收票據

	2025年 千港元	2024年 千港元
貿易應收款項	1,162,465	650,700
信貸虧損撥備	<u>(8,508)</u>	<u>(5,763)</u>
	1,153,957	644,937
應收票據	19,946	13,481
信貸虧損撥備	<u>-</u>	<u>(64)</u>
	<u>1,173,903</u>	<u>658,354</u>

本集團與客戶的貿易條款主要為信貸條款。信貸期一般介乎0至120天(2024年：0至120天)。應收票據的一般到期期限介乎30至180天(2024年：30至180天)。本集團力求嚴格監控其未收回應收款項。逾期結餘由董事定期審閱。

於報告期末，貿易應收款項按各自發票逾期日期呈列的賬齡分析(扣除信貸虧損撥備)及應收票據按票據發行日期呈列的賬齡分析(扣除信貸虧損撥備)如下：

	2025年 千港元	2024年 千港元
貿易應收款項		
未逾期	1,074,049	599,910
0-60天	79,259	44,189
61-120天	649	836
超過120天	<u>-</u>	<u>2</u>
	<u>1,153,957</u>	<u>644,937</u>
應收票據		
0-60天	<u>19,946</u>	<u>13,417</u>

10. 貿易應付款項及應付票據

	2025年 千港元	2024年 千港元
貿易應付款項	468,658	337,204
應付票據	25,535	4,670
	<u>494,193</u>	<u>341,874</u>

貿易應付款項的信貸期介乎0至60天(2024年：0至60天)。

本集團貿易應付款項及應付票據按發票日期呈列的賬齡分析如下：

	2025年 千港元	2024年 千港元
0-30天	467,423	274,623
31-60天	19,920	48,047
61-90天	2,813	11,980
超過90天	4,037	7,224
	<u>494,193</u>	<u>341,874</u>

11. 銀行及其他借貸

	2025年 千港元	2024年 千港元
有抵押銀行貸款	331,002	95,540
有抵押銀行貸款—供應商融資安排	200,266	205,305
	<u>531,268</u>	<u>300,845</u>
其他借貸(有抵押)	—	5,344
	<u>531,268</u>	<u>306,189</u>

銀行及其他借貸須於以下時間償還：

	2025年 千港元	2024年 千港元
一年內	90,823	50,121
超過一年但不超過兩年	814	1,126
超過兩年但不超過五年	582	1,404
	<u>92,219</u>	<u>52,651</u>
含有按要求償還條款的部分銀行及其他借貸 (於流動負債項下列示)	<u>439,049</u>	<u>253,538</u>
	531,268	306,189
減：於12個月內結算的款項(於流動負債項下列示)	<u>(529,872)</u>	<u>(303,659)</u>
於12個月後結算的款項	<u>1,396</u>	<u>2,530</u>

若干銀行融資載有若干契諾，包括維持一定的財務比率，並對應收董事及關聯公司款項以及關聯方交易的最高金額設有限制。倘若本集團違反契諾，相關借貸將須按要求償還。本公司董事已審閱契諾遵守情況並表示就彼等所知，於兩個年度並不存在違約情況。

末期股息

董事會決議建議向於2026年6月5日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)宣派本公司截至2025年12月31日止年度的末期股息每股14港仙(2024年：每股10港仙)。本年度，董事會宣派中期股息每股3港仙，因此，本年度的股息總額為每股17港仙(2024年：股息總額為12港仙，包括中期股息2港仙及末期股息10港仙)。待股東於2026年5月22日(星期五)舉行的應屆股東週年大會(定義見下文)上批准後，建議末期股息預計將於2026年6月26日(星期五)或其前後派付。

股息政策變動

董事會已議決並批准修訂股息派付比率，由不低於本集團於歸屬於本公司擁有人的年度綜合淨利潤的50%修訂為不低於15%，旨在動用留存收益把握市場增長機遇及用於未來業務發展及營運。除上述修訂外，股息政策的其他條款維持不變。

股東應注意，本公司派付股息的能力將取決於(其中包括)本集團的整體財務狀況、本集團當前及未來的營運、流動資金狀況及資本需求，以及自本公司附屬公司收取的股息。本公司派付股息亦須受開曼群島法律及本公司組織章程細則的任何限制所規限。

董事會將繼續不時檢討股息政策，概不保證於任何特定期間會按任何特定金額派付股息。

管理層討論及分析

業務回顧

近年來，全球經濟在多重挑戰下呈現出複雜且分化的發展格局。IMF預計2025年全球的平均通脹率降至4.2%左右，主要經濟體央行陸續結束緊縮週期。在此背景下，全球商品貿易呈現「先抑後揚」的復蘇態勢。世界貿易組織(WTO)將全球貨物貿易增長率預測值，由2025年初的-0.2%上調至最新的2.4%。增長動力來自AI相關產品需求激增、以及新興經濟體貿易活力增強。

2025年，中國經濟整體保持平穩增長態勢。國家統計局初步核算的資料顯示，全年國內生產總值達到140.19萬億元，按不變價格計算同比增長5.0%，增速在全球主要經濟體中保持領先。其中，社會消費品零售總額同比增長3.7%達到50.12萬億元，消費市場「壓艙石」的作用持續穩固。資料顯示，中國製造業佔全球比重接近30%，已連續16年位居世界首位。貨物貿易進出口總額連續九年正增長，貿易順差首次突破萬億美元。

在產業投資方面，地緣政治及關稅戰的不確定性延緩了投資決策，導致全球直接投資增速放緩。同時，為規避關稅衝擊，全球供應鏈的重構壓力加大，正推動部分企業加速向東南亞、墨西哥、印度等地區轉移產能。標普(SPGI)發佈的白皮書顯示，關稅壁壘預計將在2025年導致全球企業損失超過1.2萬億美元，而全球供應鏈重構的潛在成本高昂，推高了中間品貿易價格。與此同時，供應鏈重構正在重塑全球貿易形態，主要特徵包括區域化、多元化和近岸外包等趨勢，區域貿易協定為這一轉變提供框架。這種供應鏈的區域化與短鏈化，短期內會顯著推高製造業的資本支出與運營成本，中長期則可能因效率損失對企業的盈利能力構成挑戰。整體而言，全球製造業已從過去數十年追求的「效率最優」導向，轉向對「效率、安全與韌性」三重目標進行動態平衡。在此背景下，構建彈性供應鏈已成為企業的核心競爭力。

電子產業與半導體芯片：AI驅動的新增長週期

2025年，全球電子產業在人工智能(AI)的驅動下繼續保持強勁復蘇。根據Gartner的報告，全年IT總支出預計同比增長7.9%至5.43萬億美元，其中，因AI算力需求激增，資料中心系統支出實現了42.4%的爆發式增長。與此同時，AI PC的興起與企業換機潮共同推動了全球PC市場的明確回暖。Omdia的資料顯示，以AI智能眼鏡為代表的新興智能硬體市場也增長迅速，2025年全球出貨量達到870萬台，同比劇增322%。端側AI產品的加速落地正催生新一輪換機熱潮，為行業帶來了結構性的增長機遇。

全球半導體產業正經歷一場由AI驅動的深刻結構性變革。算力基礎設施建設的爆發性需求成為2025年推動半導體市場增長的核心動力，而智能手機、個人電腦等傳統應用市場則表現相對疲軟。這種結構性分化凸顯了AI的決定性影響力，若剔除高性能記憶體和邏輯芯片等AI相關領域的貢獻，傳統半導體市場的增長實則有限。這標誌著行業已全面進入由AI定義的結構性增長新週期。

在此全球背景下，中國電子資訊製造業表現突出，2025年規模以上工業增加值同比增長10.6%，顯著高於同期工業整體增速。面對高端技術的外部限制，中國正加速在成熟制程領域的規模化擴張。SEMI的統計顯示，2025年中國大陸成熟制程產能增速高達14%，遠超6%的全球平均增幅，其全球晶圓月產能佔比已提升至近三分之一，達到等效1010萬片(8英寸)。海關資料顯示，同年中國芯片出口額增長27.4%，且出口均價與進口均價的差距呈收窄趨勢，反映出國產芯片正向中高端邁進。但是，高端芯片領域的需求缺口依然巨大，全年高達3.04萬億美元的芯片進口額顯示，實現產業鏈全面自主可控依舊任重道遠。

集團業務回顧

2025年，集團圍繞AI科技主線梳理和調整業務結構，重點拓展算力基建、端側AI SoC及存儲領域市場，並積極推動混合分銷和技術增值業務協同發展。在此戰略佈局下，公司盈利能力和市場競爭力得到顯著提升。各業務單元的年度回顧如下：

智能終端

SoC (System on Chip) 芯片是集成多功能模組的電子產品控制中樞。其技術演進聚焦于集成NPU(神經網路處理單元)，以滿足終端設備本地低延遲、高能效的計算需求。2025年，集成NPU的AI SoC芯片出貨量持續增長，但應用分化明顯：在機器人、工業視覺等高算力領域滲透迅速，而在成本敏感的低端應用中則滲透緩慢。

2025年，隨著輕量化大模型向終端滲透，智能汽車、AI PC與邊緣計算需求同步增長，帶動市場對高算力、低功耗、強連接AI SoC芯片的需求快速提升，端側與邊緣AI芯片進入高速成長期。端側AI SoC的核心價值在於當地語系化處理能力，可實現低延遲回應、隱私保護及更低的網路頻寬依賴。

市場規模方面，多家機構看好其增長前景。Markets and Markets預測，全球SoC市場到2029年將達2060億美元；弗若斯特沙利文則預計，全球端側AI市場到2029年將達12320億元，年均複合增長率39.6%，顯示AI SoC在整體SoC市場中的佔比有望持續提升。這預示著AI SoC在整體SoC市場中的份額將快速擴大，標誌著端邊側智能時代的全面來臨。

本業務單元與業內多家知名的SoC芯片原廠建立深度的合作關係，為行業客戶提供涵蓋芯片供應鏈保障、定制化技術解決方案及全週期技術支援等綜合服務，帶動本業務單元2025年的業績穩步增長，年度累計實現銷售額3,849.2百萬港元，同比顯著增長20.5%。

存儲產品

本集團在存儲領域產品佈局完善，覆蓋DRAM、NOR Flash、NAND Flash、MCP、KGD及eSSD等多類存儲芯片與模組產品，可滿足從移動終端到資料中心等多場景需求。

經歷2024年庫存出清後，2025年存儲行業進入新一輪上行週期，人工智能需求成為核心驅動力。AI伺服器對高頻寬記憶體(HBM)和DDR4/DDR5的爆發性需求，帶動存儲芯片成為半導體行業復蘇的重要引擎。根據CFM快閃記憶體市場統計，2025年全球存儲芯片市場規模同比增長32.7%，達到2216億美元。

行業資料顯示，一台AI伺服器對DRAM的容量需求約為傳統伺服器的8倍，NAND的容量需求為3倍。疊加AI伺服器出貨量本身的增長，共同推動存儲芯片需求激增，並引發DRAM市場的供需失衡。為優先保障高利潤的HBM訂單交付，主要廠商將產能轉向HBM。由於製造相同容量的HBM，需消耗相當於普通DRAM芯片3至4倍的產能，這嚴重擠佔了傳統DRAM的供給，導致其價格持續攀升。在NAND快閃記憶體市場，AI的拉動效應體現在高性能企業級固態硬碟(eSSD)領域。資料中心和AI算力基礎設施建設推動了對大容量、高性能eSSD的需求，使其成為增長最快的細分市場。

綜上所述，得益於AI產業對存儲芯片市場需求的強力推動，2025年DRAM價格穩步上漲，NAND Flash價格也在下半年開始回暖，並在第四季度迎來大幅反彈，整體呈現出「價升量增」的強勁發展態勢，推動存儲產業正步入由AI應用驅動的高景氣週期。本業務單元與多家知名的存儲芯片原廠保持緊密合作，結合集團優質的客戶群體，帶動本業務單元2025年的業績取得大幅成長，累計實現銷售額1,903.2百萬港元，同比大幅增長149.3%。

算力基建

本業務單元專注於算力基礎設施領域的光電器件供應，核心產品包括應用於200G/400G/800G/1.6T等高速數通光模塊的發射芯片(如DFB、VCSEL、EML)和接收芯片(如PD、APD)。收發芯片是光通信模組中技術含量最高的器件，具備製造工藝複雜、技術壁壘高等特點，通常在高速光模塊中的成本佔比過半。

得益於人工智能算力基礎設施投入大幅增長和資料中心互聯需求的指數級攀升，2025年全球光模塊市場呈現出強勁的增長勢頭，市場規模顯著擴大。中國信通院聯合IDC發佈的《全球光模塊市場發展白皮書(2025)》顯示，預計2025年全球光模塊出貨量突破3,400萬隻，市場規模同比增長約50%達到230億美元。其中，數通領域的以太網光模塊是市場增長的核心驅動力，而電信光模塊市場則保持相對穩健。

當前，800G光模塊已成為市場主流。多家機構預計，2025年800G光模塊需求量將達1,800萬至2,200萬隻，主要受AI算力集群建設驅動。同時，1.6T等更高速率產品已開始小批量出貨，行業正逐步向更高速率演進。光模塊的收發芯片作為其核心元器件，其市場發展與光模塊市場高度相關。得益於400G/800G產品的規模上量，2025年全球光器件市場的收入顯著增長，預計規模超過160億美元。此外，光模塊速率的持續迭代提升是推動光器件市場增長的另一個關鍵引擎。從800G向1.6T的技術升級，將為光器件市場注入新的增長動力。全球算力基建的持續投入構成了光電器件市場長期向好的堅實基礎，本業務單元依託與全球領先光通信芯片原廠的深度戰略合作，基於集團多年積累的光模塊優質客戶資源，構建端到端技術—市場閉環，推動業務實現持續增長。2025年我們累計銷售額737.2百萬港元，同比增長15.9%。

混合分銷

電子元器件分銷模式主要分為授權分銷、獨立分銷和混合分銷三類，其中混合分銷融合了授權分銷和獨立分銷兩種業務。與授權分銷不同，獨立分銷業務的貨源來自全球市場，通過整合原廠、OEM/CEM過剩庫存及同業管道，主要服務於緊急現貨需求、小批量採購及停產物料調配。在供應鏈生態中，獨立分銷是一種由市場機制驅動的去中心化供應鏈網路。在2025年存儲芯片短缺的大背景下，獨立分銷商成為眾多製造企業獲取關鍵芯片的重要管道，其在保障供應鏈韌性方面的價值得到市場的普遍確認。QYResearch發佈的資料顯示，2024年全球電子元器件分銷市場規模約為2,033億美元，預計2031年將增長到2,836億美元，年複合增長率為4.9%。

本業務單元是集團打造全能型分銷體系的重要一環，可以對集團的授權分銷和技術增值業務形成有效補充，構建更全面和靈活的供應鏈服務能力。我們通過捕捉市場供需失衡以及產業鏈週期性錯配帶來的業務機遇，採用資料撮合匹配與快速高效的供應鏈服務來創造價值，從而提升公司的經營指標。2025年，受益於市場對供應鏈彈性的迫切需求，本業務單元客戶數量與訂單金額均實現明顯回升，累計實現銷售額100.5百萬港元，同比大幅增長88.3%。

業務展望2026

2026年，全球經濟仍處於一個充滿不確定性與結構性變革的關鍵節點，風險與機遇並存。聯合國1月發佈的《2026年世界經濟形勢與展望》報告中預測，2026年全球經濟增速為2.7%，略低於2025年預估的2.8%。在此背景下，中國經濟運行將呈現「穩中有進、結構優化、動能轉換」的特徵，市場普遍預計中國GDP增速維持在4.5%至5%的合理區間。消費市場和投資結構將繼續得到改善，海外出口保持較強韌性，經濟運行總體保持平穩。其中，作為國民經濟的關鍵支柱，電子資訊製造業將展現出強勁的創新活力和競爭力。

賽迪研究院在《2026年我國電子資訊製造業發展形勢展望》報告中預測，2026年中國電子資訊製造業增加值的增速將處於5%至8%的區間。其中機電產品出口仍是重要的支柱，在家電、消費電子、機械設備等傳統機電產品出口保持穩定的同時，以半導體芯片、工業機器人為代表的新興高技術領域出口預計將保持較快增長，為機電產品出口結構優化注入新的增長動能。

2026年，全球半導體產業將繼續保持高速增長。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)年初發佈的最新預測資料，2026年全球半導體市場規模將繼續大幅增長，達到創紀錄的9,750億美元，距離萬億美元大關僅一步之遙。此輪增長的核心動力仍然源自於人工智能(AI)產業的爆發式推動，AI應用的深度和廣度不斷拓展，將帶動推理算力需求呈現指數級增長，此外，端側AI設備也將迎來新的發展契機，共同驅動半導體市場邁向新的高度。

智能終端：AI SoC引領端側智能新浪潮

隨著AI從雲端計算向物理世界加速滲透，其與終端設備的深度融合使終端具備了更強的感知、行動和自主交互能力，從而推動端側AI成為硬體發展的新主線。得益於羽量級AI模型推理能力的優化與芯片算力顯著提升，在本地硬體上實現高效的語音辨識、圖像生成、智能助手等AI功能成為現實，這使得終端設備不再完全依賴雲端算力。這一趨勢的核心驅動力在於AI SoC(系統級芯片)在技術架構與能效比上的持續迭代創新。

2026年，AI將對半導體產業發展帶來更為深遠的影響，隨著AI PC和AI手機的加速普及，消費者對內置AI處理能力的智能設備需求將顯著增長，這將極大地推動AI SoC芯片、低功耗AI加速器以及相關存儲芯片市場的增長。市場研究機構Forrester發佈的報告指出，企業將模型推理從雲端遷移到邊緣設備可降低40%至70%的AI運營支出。因此，AI SoC驅動的端側智能浪潮，正在開啟半導體產業未來5-10年的黃金增長通道，並重塑電子產品形態與產業發展格局。SHD Group在2025年4月發佈的預測報告顯示，邊緣AI SoC市場營收將從2024年的324億美元增長到1,029億美元，年平均複合增長率達到21.2%。

綜上所述，本業務單元聚焦拓展的AI SoC市場，作為實現本地推理、保障低時延、保護使用者隱私的關鍵硬體，其出貨量穩步上升，成為推動半導體市場增長的新引擎。未來我們將聚焦智能穿戴、智慧視覺、機器人等具備高發展潛力的新興賽道，推動業務穩健發展。

存儲：AI驅動的高景氣超級週期

2026年，全球存儲芯片市場正經歷由AI算力基礎設施驅動的結構性變革。增長引擎已從智能手機、PC等消費電子的容量升級，全面轉向AI伺服器及端側AI設備的需求。行業資料顯示，單台AI伺服器的DRAM配置從傳統的128-256GB激增至1-2TB，並普遍採用高價值的HBM(高頻寬記憶體)，推動DRAM市場規模呈現爆發式增長。

AI Agent推動應用正在從單次推理向具備百萬級Token長期記憶和自主決策演進，其多輪對話、工具調用等功能導致Token消耗量是普通Chat的10至50倍。這不僅強化了對HBM和DRAM的頻寬與容量需求，也大幅增加了對高IOPS企業級eSSD的需求。由於AI伺服器對存儲容量的配置需求顯著高於傳統伺服器，eSSD正迅速成為NAND Flash芯片最大的應用市場之一。

存儲芯片需求已滲透至端側設備。為支援本地大模型推理，智能手機、PC等終端需配備更高容量的LPDDR5X和UFS 4.0以上嵌入式存儲。主流AI眼鏡普遍採用2GB DRAM+32GB NAND Flash的組合，部分高端型號配置更高。更關鍵的是，AI端側硬體憑藉創新性功能，能夠更好消化存儲用量增長帶來的成本上升，獲取供應鏈資源時具備更強議價能力。權威機構TrendForce預測，2026年全球存儲產業總產值將達5,516億美元，其中DRAM收入規模預計將同比增長144%至4,043億美元，NAND Flash收入規模預計將同比增長112%至1,473億美元，2027年規模預計將進一步增長至8,427億美元。

綜上所述，基於集團在存儲市場多年來的深厚佈局，以及在客戶群體和產品線上積累的豐富資源，本業務單元對2026年的業務成長持積極樂觀的態度。我們有充分的信心把握此輪AI浪潮帶來的歷史性發展機遇，推動業務實現跨越式成長。

算力基建：機遇與挑戰並存

2026年，全球AI算力基礎設施持續投入，推動光模塊市場進入結構性增長新階段。TrendForce報告指出，2026年全球八大雲服務商資本支出預計大增61%達7,100億美元，而且投資熱潮將延續數年。LightCounting和高盛等機構的資料顯示，2026年全球數通光模塊市場規模預計將達到260-300億美元，同比增長13-30%。值得關注的是，數通市場在2024年的佔比已超過60%，標誌著行業驅動力從傳統電信領域轉向以AI為核心的算力基礎設施建設。

目前，光模塊行業正在從「數量擴張」向「品質升級」躍遷，800G與1.6T光模塊將成為市場的絕對主流。其中，預計800G模組出貨量將增長一倍以上，新一代的1.6T光模塊在2026年將迎來普及，其出貨量有望從2025年的小基數猛增至數千萬埠級別。這種高速率迭代不僅帶來基於規模的增長，也將通過技術升級帶來的溢價提升產品的毛利率。

值得注意的是，AI伺服器互聯架構的演進正從根本上改變光模塊的地位與需求量級。早期AI伺服器大量使用銅互聯，當時GPU與光模塊配比約為1：3。在銅互聯和光互聯的混合連接方案中，該配比提升至1：4。而在最新的「全光互聯」新架構中，該比例已提升至1：6以上。超大規模算力集群對光模塊的需求規模龐大，例如華為Atlas 950 SuperCluster集群，包含超過52萬張的昇騰算力卡，其光模塊的總需求預計在222萬到300萬個之間。因此，無論是英偉達宣導的「銅轉光」趨勢，還是華為的「全光互聯」技術路線，都將光模塊從「連接配件」提升至「核心基礎設施」地位。

綜上所述，2026年光模塊行業正處在AI算力基建高景氣度的核心賽道上。市場規模在高資本支出的推動下穩步擴張，將為本土光芯片及模組企業創造結構性的增長機遇。基於對行業趨勢和客戶的深刻把握，本業務單元有信心在2026年把握市場技術迭代帶來的紅利，實現業務的穩健與高品質發展。

混合分銷：傳統業務的新機遇

全球電子元器件供應鏈的持續波動，為混合分銷模式帶來了新的發展機遇。Research Nester報告顯示，全球電子元器件分銷市場規模在2026年預計將同比增長7.7%至2,161億美元，並有望在2035年達到3,912億美元。這一增長的核心動力源自於汽車電子、5G/6G電信基礎設施、工業自動化和物聯網(IoT)設備的巨大市場潛力。

全球半導體市場的週期性供需波動，為獨立分銷業務的發展創造重要機遇。在原廠產能緊張或交付週期拉長時，客戶對保障穩定供應鏈的迫切需求成為推動該業務成長的關鍵驅動力。獨立分銷商能夠憑藉其全球化的尋源能力和靈活的庫存管理，說明客戶降低因市場缺貨帶來的供應鏈斷鏈風險，通過有效整合原廠、授權販售者及其他過剩庫存資源，建立多元化的供應商網路以增強客戶的供應鏈韌性。

此外，為適應日趨嚴格的貿易合規要求，分銷商需建立完善的合規體系以應對複雜的許可證申請與審查流程。強化供應鏈的透明度和可追溯性，不僅是合規的強制要求，也已成爲客戶選擇供應商的重要考量因素。這將顯著提升行業的准入門檻，對具備規範運作能力、擁有強大法務和關務團隊的中大型分銷商更爲有利。與此同時，數位化轉型正成爲推動分銷業務升級的新動力，特別是AI技術在需求預測、庫存優化、風險預警等供應鏈管理環節的應用日趨成熟，可以有效地提升供應鏈的服務品質和運營效率。

因此，2026年將是混合分銷業務轉型升級的關鍵時間節點，本業務單元將致力於通過把握市場增長機遇，構建韌性全球供應鏈網路、健全合規管理體系，並強化數位化、AI化運營能力，在複雜多變的市場環境中確立差異化競爭優勢，實現可持續發展。

小結

人工智能作爲當前最具變革性的通用目的技術(GPT)，正在重塑全球經濟、產業與社會結構。由於AI系統高度依賴先進的AI算力、高速資料存儲和低延遲的資料傳輸能力，使其與先進半導體技術形成深度耦合的共生關係。在AI算力需求爆發的推動下，全球半導體產業正迎來新一輪繁榮週期。麥肯錫的分析模型顯示，到2030年，全球半導體市場規模將達到1.1萬億至1.8萬億美元之間，其中等風險情景下約爲1.6萬億美元，核心增長動力源自AI伺服器、高頻寬記憶體(HBM)、先進封裝技術及汽車電子等領域的強勁需求。

綜上所述，雖然全球經濟在2026年仍面臨諸多挑戰，但市場並不乏增長機遇。尤其是半導體產業在AI的驅動下，正在經歷一個前所未有的繁榮週期，這為我們業務發展提供歷史性機遇。集團作為中國本土領先的全能型電子元器件分銷商，依託在授權分銷、獨立分銷、技術增值服務及光通信芯片製造等領域的全鏈條佈局，與產業鏈上下游合作夥伴建立穩固的業務合作。我們將持續在AI相關的軟硬體領域內深度耕耘，積極推進企業的業務數位化與AI化轉型工作，持續關注並捕捉AI帶來的多維度產業紅利，並積極建設國內和海外的業務網路，構建一個更具韌性的全球化供應鏈體系。未來，我們將在穩健經營與積極創新的基礎上，不斷提升業務品質與盈利能力，致力於為股東創造更長遠、更豐厚的回報與價值。

財務回顧

收入

截至2025年12月31日止年度，本集團收入為6,590.1百萬港元(2024年：4,647.9百萬港元)，較截至2024年12月31日止年度的收入增加1,942.2百萬港元(或41.8%)。

收入增加乃主要由於來自智慧終端及存儲產品的銷售額增加約1,793.7百萬港元。

毛利

截至2025年12月31日止年度，我們的毛利較去年增加97.8百萬港元至409.5百萬港元(2024年：311.7百萬港元)。截至2025年12月31日止年度，我們的毛利率下降0.5%至6.2%(2024年：6.7%)。毛利率下降乃主要由於來自存儲產品的銷售額增加，該產品毛利率較低。

研發費用

研發費用主要包括我們的研發部門所產生的員工成本。截至2025年12月31日止年度，研發費用為34.2百萬港元，較截至2024年12月31日止年度增加8.9%(2024年：31.5百萬港元)。

行政、銷售及分銷費用

截至2025年12月31日止年度，行政、銷售及分銷費用合共為219.0百萬港元(2024年：178.1百萬港元)，佔截至2025年12月31日止年度收入的3.3%，而2024年同期則為3.8%。淨增加40.9百萬港元乃主要由於銷售及分銷人員的銷售佣金及員工成本增加所致。

財務費用

截至2025年12月31日止年度，本集團的銀行及其他借貸利息費用為30.4百萬港元，較2024年增加3.8百萬港元(2024年：26.6百萬港元)。利息費用主要指與若干主要往來銀行訂立多項保理協議而產生的借貸成本及來自主要往來銀行的進口貸款。該增加乃由於年內銀行借貸增加。

應佔聯營公司業績

截至2025年12月31日止年度，本集團錄得應佔聯營公司業績利潤約38.7百萬港元(2024年：7.1百萬港元)。該利潤乃主要由於應佔一間聯營公司，即銘冠集團業績。應佔聯營公司業績增加乃主要由於銘冠集團業務營運改善。

年度利潤

截至2025年12月31日止年度，本集團的利潤為161.1百萬港元，較2024年的101.1百萬港元增加60.0百萬港元，增幅為59.4%。截至2025年12月31日止年度的純利潤率為2.4%，而截至2024年12月31日止年度則為2.2%。年度利潤增加乃主要由於授權分銷銷售的毛利增加所導致。

本公司擁有人應佔淨利潤

截至2025年12月31日止年度，本公司擁有人應佔淨利潤達161.4百萬港元，較截至2024年12月31日止年度增加60.8%（2024年：100.3百萬港元）。

全球發售所得款項用途

本公司股份於2016年10月7日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（「上市」）。本公司按每股股份1.83港元發行125,000,000股面值為0.00001美元的新股份。經扣除有關上市之承銷費用及估計開支後，本公司所收取之來自上市的所得款項淨額約為205.8百萬港元。

於2025年12月17日，董事會已議決變更上市籌集的所得款項淨額23.9百萬港元的用途。該未動用所得款項先前分配用於升級、進一步發展及維護我們的電商平台以及改良技術基礎設施。鑒於本集團電商平台的現有發展水平已足以達成及維持該主要目的，董事會議決將該未動用款項中的約8.4百萬港元用於與銷售AI相關電子元器件有關的市場推廣及營運開支以及獲取AI相關電子元器件的額外分銷授權，另將約15.5百萬港元用於招聘研發人員以提供與本集團AI相關電子元器件業務附帶的技術支援及解決方案服務。有關詳情，請參閱本公司日期為2025年12月17日及2026年1月9日的公告（「該等公告」）。

截至2025年12月31日止年度，本集團已動用上市所得款項淨額0.1百萬港元。本集團於2025年12月31日已根據載於本公司日期為2016年9月27日的招股章程（「招股章程」）的擬定用途累計動用約181.9百萬港元之所得款項淨額。未動用所得款項淨額23.9百萬港元已作為存款存放於持牌銀行，並擬按招股章程及該等公告所載用途動用。

所得款項用途	所得 款項淨額 (百萬港元)	截至2025年 12月31日 止年度內 已動用款項 (百萬港元)	於2025年 12月31日 累計 已動用款項 (百萬港元)	剩餘款項 (百萬港元)	預期動用剩餘 所得款項淨額 時間線 (附註1及2) (百萬港元)
1. 招募新員工進行銷售及 營銷以及業務發展，並升 級倉庫設施	20.6	0.0	(20.6)	0.0	-
2. 為推廣電商平台、芯球計 劃及新產品投放廣告及 組織營銷活動	41.2	0.0	(41.2)	0.0	-
3. 升級、進一步發展及維護 我們的電商平台以及改 良技術基礎設施	17.3	(0.1)	(17.3)	0.0	
4. 用於研發	20.6	0.0	(20.6)	0.0	-
5. 為潛在收購或投資電商 行業或電子行業的業務 或公司撥資	61.7	0.0	(61.7)	0.0	-
6. 開發智能終端、邊緣運算 及其他領域的解決方案， 以及投資於AI相關芯片 的分銷授權及市場推廣					
— 與銷售AI相關電子元 器件有關的銷售與經 營費用	8.4	0.0	0.0	8.4	預期於2028年 12月31日 或之前 悉數動用
— 招募研發人員	15.5	0.0	0.0	15.5	預期於2028年 12月31日 或之前 悉數動用
7. 一般營運資金	20.5	0.0	(20.5)	0.0	-
	<u>205.8</u>	<u>(0.1)</u>	<u>(181.9)</u>	<u>23.9</u>	

附註：

1. 預期動用剩餘所得款項淨額時間線按本公司最佳預測制定，當中考慮(其中包括)目前及日後市場狀況及業務發展及需要，因此可能會發生變動。
2. 於2025年12月17日，董事會已決議更改上市所得款項淨額23.9百萬港元的用途。有關詳情請參閱該等公告。

流動資金及財務資源

本集團的主要資金來源包括自其經營業務產生的現金及銀行授出的信貸融資。

本集團擁有充足的現金及可用銀行融資以滿足其承擔及營運資金需求。於2025年12月31日，本集團之受限制及未受限制銀行結餘及現金總額為336.6百萬港元(2024年12月31日：432.3百萬港元)。

於2025年12月31日，本集團的尚未償還銀行借貸為531.3百萬港元(2024年12月31日：306.2百萬港元)。本集團的資本負債率(按計息借貸除以權益總額計算)由2024年12月31日的31.9%增加至2025年12月31日的50.0%，原因是銀行借貸增加。

於2025年12月31日，本集團銀行融資(不包括備用信用證)總額及未動用金額分別為2,340.7百萬港元及1,809.4百萬港元(2024年12月31日：2,323.6百萬港元及2,017.4百萬港元)。

於2025年12月31日，本集團擁有流動資產1,838.8百萬港元(2024年12月31日：1,339.1百萬港元)及流動負債1,172.7百萬港元(2024年12月31日：728.9百萬港元)。於2025年12月31日的流動比率為1.57倍(2024年12月31日：1.84倍)。流動資產增加乃主要由於貿易應收款項較2024年12月31日有所增加，乃由於收入和交易量增加所致。

截至2025年12月31日止年度，本集團之貿易應收賬款週轉期為51日，而截至2024年12月31日止年度則為52日。貿易應收賬款整體週轉期在信貸期內。貿易應收賬款週轉期保持穩定。

截至2025年12月31日止年度的貿易應付賬款週轉期為25日，而截至2024年12月31日止年度則為26日。貿易應付賬款週轉期保持穩定。

截至2025年12月31日止年度的存貨週轉期為14日，而截至2024年12月31日止年度則為17日。存貨控制一直為本集團管理團隊的主要任務之一，以維持本集團的流動資金及健康的財務狀況。存貨週轉期於兩個年度均保持相對穩定。

外匯風險

本集團的交易主要以美元及人民幣計值。截至2025年12月31日止年度，儘管匯率出現波動及錄得匯兌虧損淨額約0.8百萬港元(2024年12月31日：匯兌虧損淨額0.3百萬港元)，本集團的業務經營並無經歷任何重大困難或受到重大不利影響。於本公告日期，本集團並無採納任何外幣對沖政策。然而，本集團將考慮使用外匯遠期合約降低重大外匯風險帶來的貨幣風險。

資產抵押

於2025年12月31日，透過損益按公平值列賬(「透過損益按公平值列賬」)之金融資產約134.1百萬港元(2024年12月31日：130.1百萬港元)，已保理之貿易應收賬款及應收票據約355.0百萬港元(2024年12月31日：99.0百萬港元)及銀行存款約182.7百萬港元(2024年12月31日：192.9百萬港元)已抵押作為本集團銀行借貸及融資安排的擔保。

資本承擔及或有負債

於2025年及2024年12月31日，本集團均無重大資本承擔及或有負債。

所持有的重大投資

除透過損益按公平值列賬、透過其他全面收入按公平值列賬之金融資產及於聯營公司之投資外，本集團於截至2025年及2024年12月31日止年度並無持有任何重大投資。

有關附屬公司及聯營公司的重大收購及出售事項

於截至2025年12月31日止年度，本集團附屬公司及聯營公司並無進行任何重大收購或出售。

僱員

於2025年12月31日，本集團僱員人數為324名(2024年12月31日：312名)，其中大部分駐於深圳及香港。截至2025年12月31日止年度之僱員總成本(不包括董事之酬金)約為108.6百萬港元(2024年12月31日：108.4百萬港元)。招股章程所披露有關僱員薪酬、薪酬政策、股份獎勵計劃、購股權計劃及員工發展的資料並無重大變動。

於2016年9月19日，本公司已採納股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)，且有條件批准及採納一項購股權計劃(「**購股權計劃**」)。兩項計劃將於2026年9月19日屆滿，即採納日期起計十週年當日。

就股份獎勵計劃而言，董事會可不時全權酌情甄選任何本集團董事、高級管理人員及僱員參與股份獎勵計劃(「**經甄選參與者**」)，惟須遵守股份獎勵計劃的條款及條件。釐定經甄選參與者時，董事會將考慮各項因素，包括但不限於相關經甄選參與者對本集團的當前及預期貢獻。

就購股權計劃而言，董事會(包括董事會根據購股權計劃規則為履行其任何職責而委任的任何委員會或董事會代表)可全權酌情向本集團成員公司或本公司聯營公司的僱員(不論全職或兼職)或董事要約授出購股權，以認購董事會可能釐定的有關股份數目。

員工激勵計劃

於2016年9月19日，本公司已採納一項股份獎勵計劃，且有條件批准及採納一項購股權計劃。

截至2025年12月31日止年度，受託人並無認購新股份，且受託人根據股份獎勵計劃規則及委託契據收購本公司合共10,078,000股股份且本公司並無根據股份獎勵計劃向員工授出受限制股份單位。截至2025年12月31日止年度，本集團已於綜合損益及其他全面收入表確認以股份為基礎支付的費用合共6.7百萬港元(2024年：0.3百萬港元)。於2025年12月31日，本公司並無根據購股權計劃授出或同意授出任何購股權。股份獎勵計劃及購股權計劃的進一步詳情將載列於本公司將適時刊發的2025年報「員工激勵計劃」一節。

購買、出售或贖回上市證券

截至2025年12月31日止年度，除受託人根據本公司股份獎勵計劃購買10,078,000股普通股外，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

截至2025年12月31日止財政年度後之事件

截至本公告日期，本集團於2025年12月31日後並無發生須予披露的重大後續事件。

遵守企業管治守則

董事會承諾維持企業管治高標準。董事會認為，透過採納有效的管理問責制度及高標準的商業道德來維持良好企業管治，有利於建立重要框架，以支撐本公司可持續發展及保障股東、供應商、客戶、員工及其他權益持有人的利益。

本公司已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載之《企業管治守則》(「企業管治守則」)之守則條文，作為其本身之企業管治守則。除本公告下文所披露偏離守則條文C.2.1外，於截至2025年12月31日止年度，本公司一直遵守企業管治守則所載的適用守則條文。本公司之企業管治常規基於企業管治守則所載之原則、守則條文及若干建議最佳常規訂立。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，主席與行政總裁的職務應有所區分，並不應由同一人擔任。

本公司偏離守則條文C.2.1，現時田衛東先生兼任這兩個職位。董事會相信，將主席與行政總裁的兩個職能集中於同一人士，可確保本集團內部領導的一致性，並讓本集團的整體策略規劃更有效且更高效。董事會認為，目前的安排將不會削弱權力制衡，而且這個架構將有助於本公司迅速及有效地作出及實行決策。經慮及本集團的整體狀況後，董事會將繼續檢討並考慮於適當時候將董事會主席與本公司行政總裁之職務分開。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為其自身董事進行證券交易的行為守則。本公司已向董事作出具體查詢，且所有董事已確認彼等於截至2025年12月31日止年度一直全面遵守標準守則。

充足的公眾持股

根據本公司公開可得的資料及就董事所知，於截至2025年12月31日止年度及直至本公告日期，本公司全部已發行股本的至少25%（聯交所批准及上市規則准許的規定最低公眾持股量）由公眾持有。

審核委員會

本公司已成立由三名獨立非執行董事（即湯明哲博士、許微女士及林晨博士）組成的審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報流程及內部控制系統，並向董事會提供意見和建議。審核委員會已審閱本集團截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，並與管理層討論本集團所採納之會計政策及本集團財務申報事宜。

羅申美會計師事務所的工作範疇

本集團核數師羅申美會計師事務所已就本初步業績公告所載有關本集團截至2025年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收入表及相關附註之數字與於2026年3月31日經董事會批准的本集團本年度經審核綜合財務報表中所載的數額核對一致。羅申美會計師事務所就此所做的工作並不構成核證聘用，因此羅申美會計師事務所對本初步業績公告不發表任何意見或核證結論。

刊發年度業績

本公告刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.smart-core.com.hk)。本公司截至2025年12月31日止年度的年報(載有上市規則及其他適用法例及法規規定的全部資料)將刊發於聯交所及本公司網站並應要求適時向股東寄發年報印刷本。

股東週年大會

本公司將於2026年5月22日(星期五)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會的通告將適3時按照上市規則規定之方式刊發於聯交所及本公司網站並寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於2026年5月19日(星期二)至2026年5月22日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不辦理股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於不遲於2026年5月18日(星期一)下午4時30分交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。

為釐定符合獲派建議末期股息的資格，本公司將於2026年6月3日(星期三)至2026年6月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不辦理股份過戶登記手續。為合資格獲派建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2026年6月2日(星期二)下午4時30分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。

承董事會命
芯智控股有限公司
董事長及執行董事
田衛東

香港，2026年3月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事田衛東先生(董事長)、劉紅兵先生、麥漢佳先生及鄭鋼先生，非執行董事黃梓良先生，獨立非執行董事湯明哲博士、許微女士及林晨博士。